

수신 국내 소재부품장비뿌리 관련 기업 대표
(경유)

제목 「2025 소부장뿌리 기술대전」 (TECH INSIDE SHOW 2025) 개최 안내 및 참가 협조 요청

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리부는 소재·부품·장비·뿌리 기업 간 협력 교류 및 비즈니스 성과 창출과 정부 정책 등에 대한 홍보의 場을 마련하기 위해 「2025 소부장뿌리 기술대전」을 아래와 같이 개최하고자 하오니 귀 사(기관)의 적극적인 관심과 참가를 요청드립니다.

- 아 래 -

가. 행사개요

- 행사명 : 2025 소부장뿌리 기술대전 (TECH INSIDE SHOW 2025)
- 기간/ 장소 : 2025.10.29.(수)~2025.10.31(금)
- 주 최 : 산업통상자원부
- 주 관 : 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국산업기술기획평가원(KEIT), 한국생산기술연구원(KITECH), 소재·부품·장비투자기관협의회(KITIA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 킨텍스(KINTEX)
- 주요 프로그램 : 소부장·뿌리산업 전시, 유공자 포상, 기업 성장 단계별 금융지원 사업 소개, 수출 컨설팅 및 바이어 매칭 등

나. 관련 문의

- TECH INSIDE SHOW 2025 사무국(T 031-995-8763, E-MAIL : techinside@kintex.com)

붙임 2025 소부장뿌리 기술대전 행사 안내문 1부. 끝.

